

2026年4月期 第2四半期決算説明会資料

2025年12月19日

確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く

インスパック株式会社



JQA-QMA16212



MS
CM009



(証券コード：6656)

第 1 部 2026年4月期 第 2 四半期決算概況

第 2 部 今後の成長戦略

第 1 部 2026年4月期 第 2 四半期決算概況

第 2 部 今後の成長戦略

超ハイエンドの精密電子部品外観検査で、グローバルニッチトップ

商 号	インスペック株式会社
本 社	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1
創 業	1984年（昭和59年）1月
上 場 市 場	東京証券取引所スタンダード市場
代 表 者	代表取締役社長 菅原 雅史
主 要 製 品	1. 半導体パッケージ基板向けAOI 2. 精密FPC向けロールtoロール型AOI 3. 半導体パッケージ基板向けAOS AOI：自動外観検査装置 AOS：レーザーリペア装置
従 業 員	85名
資 本 金	813百万円
発行済株式数	4,012,800株（単元株数：100株）
株 主 数	4,798名

インスペック本社
秋田県仙北市角館町



東京→角館 3H

羽田→秋田AP 1H

秋田開発センター
秋田県秋田市

長野サポートセンター
長野県長野市

蘇州サポートセンター
中国蘇州

非連結子会社
Inspec TAIWAN
台湾桃園市

タイ・ベトナムに
サポート体制有り

東京オフィス
東京都港区浜松町

滋賀サポートセンター
滋賀県草津市

春

夏

秋

冬

角館の四季

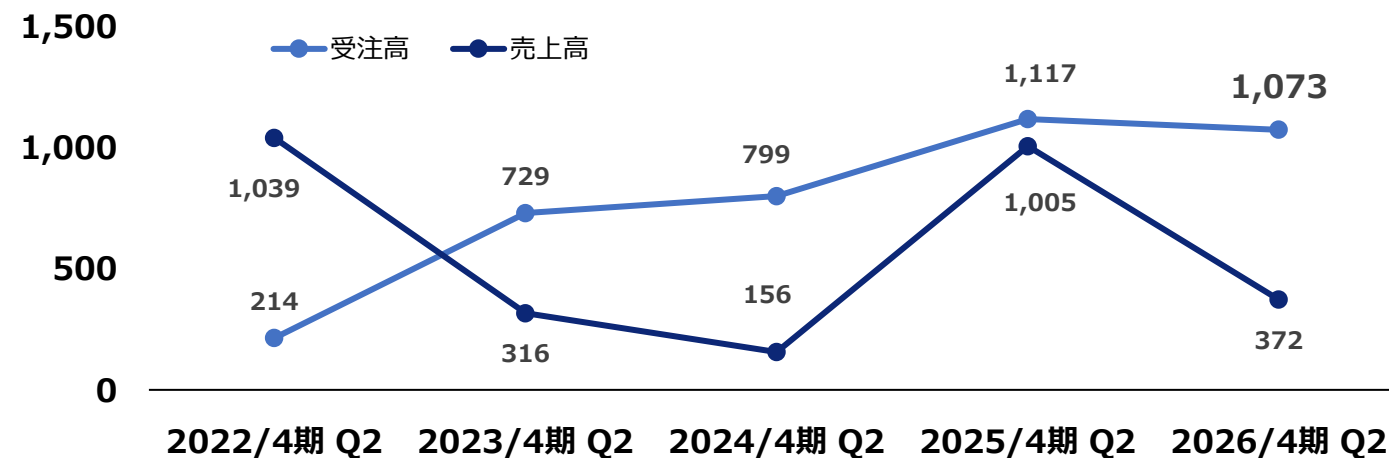
受注案件の大規模化により納期が下期に集中、当期売上計画は下期に偏重した計画
通期見通しに向け、期初の計画通りに進捗中

(単位：百万円)

	2026年4月期 第2四半期	2025年4月期 第2四半期	前年同期比	増減率
売上高	372	1,005	△633	△62.9%
営業利益	△205	1	△206	－
経常利益	△214	13	△227	－
当期純利益	△216	10	△226	－

過去5年間の推移

(単位：百万円)

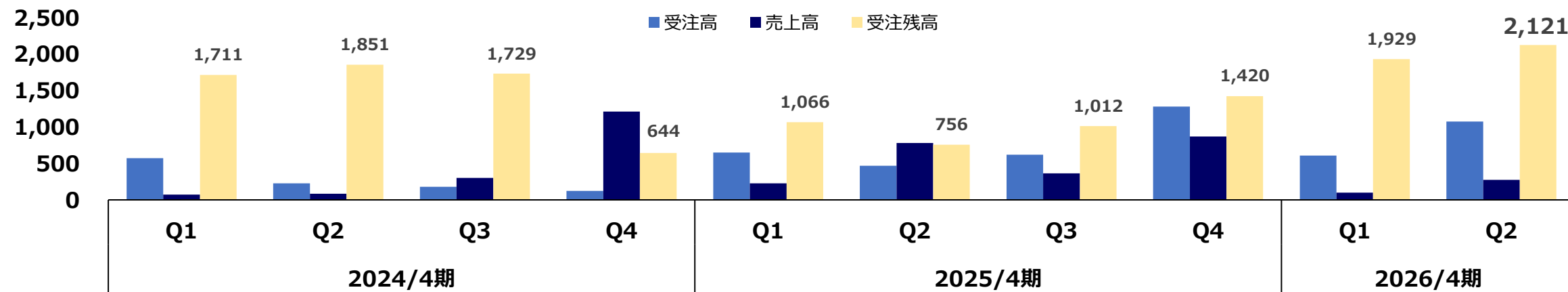


2026/4期 Q2累計受注高
1,073百万円 (前年同期比 3.9%減)

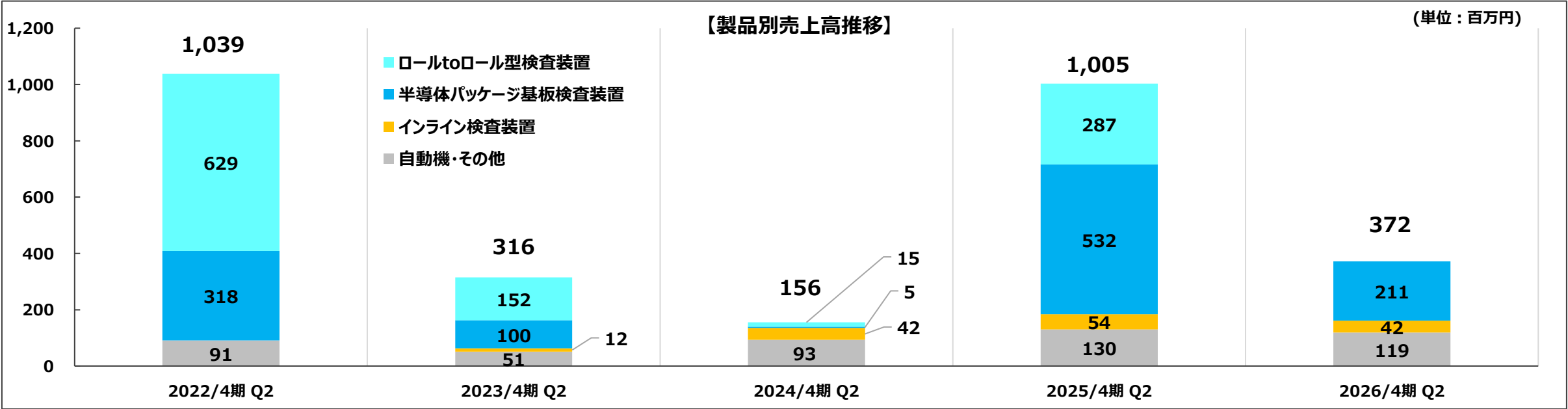
2026/4期 Q2末受注残高
2,121百万円 (前年同期比 180.4%増)

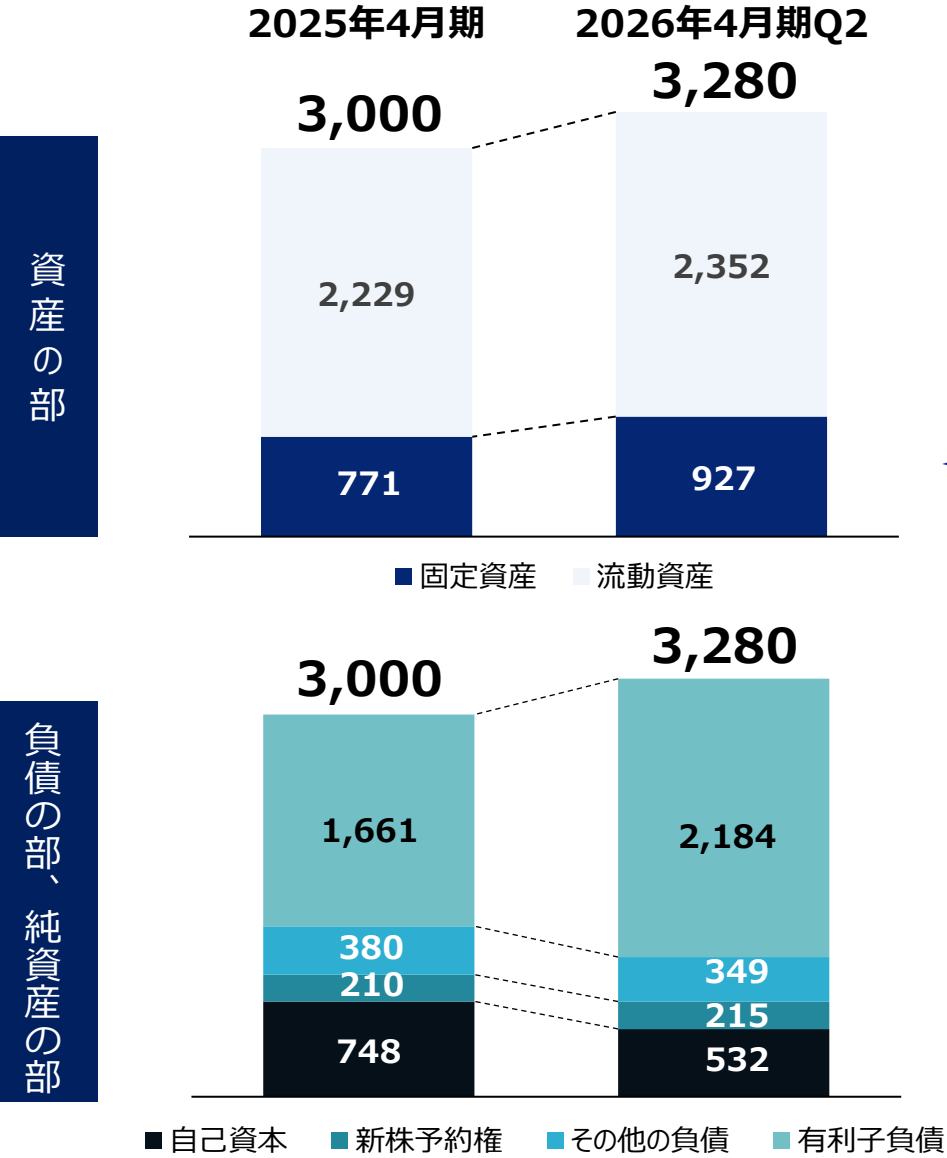
四半期毎の推移

(単位：百万円)



	2026年 4 月期Q 2		2025年 4 月期Q 2		前年同期比 増減率
	金額（百万円）	構成比	金額（百万円）	構成比	
売上高合計	372	100.0%	1,005	100.0%	△62.9%
■ ロールtoロール型検査装置	0	0.0%	287	28.6%	△100.0%
■ 半導体パッケージ基板検査装置	211	56.7%	532	53.0%	△60.2%
■ インライン検査装置	42	11.3%	54	5.4%	△22.8%
■ 自動機・その他	119	32.0%	130	13.0%	△8.5%





	2025年4月期	2026年4月期Q2
自己資本	748百万円	532百万円
自己資本比率	24.9%	16.2%

【主な増減要因】

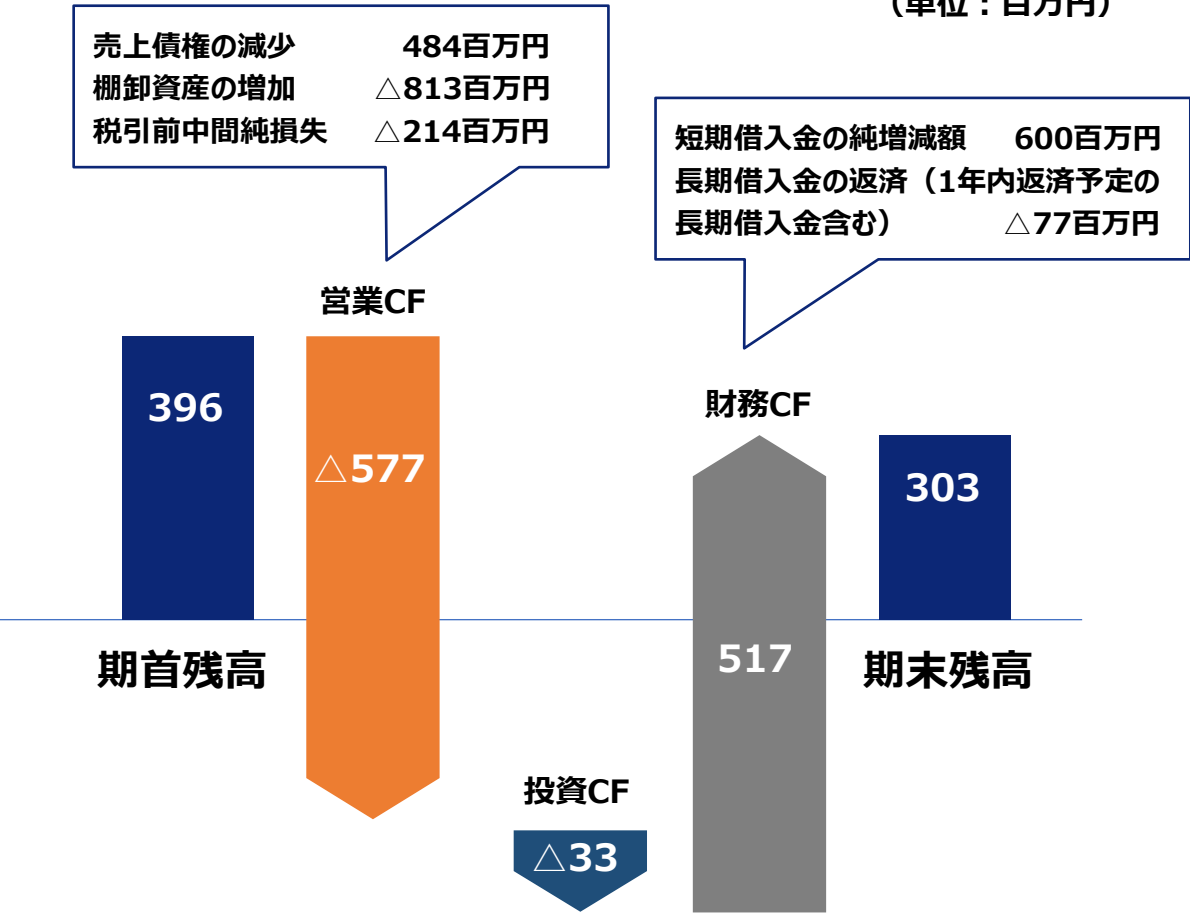
現金及び預金：113百万円減少
売掛金及び契約資産：279百万円減少
電子記録債権：204百万円減少
仕掛品：624百万円増加
建設仮勘定：177百万円増加

短期借入金：600百万円増加
長期借入金：66百万円減少

中間純損失の計上：216百万円

現金及び現金同等物 92百万円の減少

(単位：百万円)



(単位：百万円)

	2025年4月期 Q2	2026年4月期 Q2
期首現金及び 現金同等物残高	594	396
営業活動による キャッシュ・フロー	157	△577
投資活動による キャッシュ・フロー	△59	△33
フリー キャッシュ・フロー	98	△610
財務活動による キャッシュ・フロー	△183	517
現金及び現金同等 に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物 の増減額（減少△）	△84	△92
期末現金及び 現金同等物残高	509	303

	2026年4月期Q2		2025年4月期Q2		対前年 増減率
	金額（百万円）	対売上比	金額（百万円）	対売上比	
基板検査装置関連事業	124	33.3%	128	12.8%	△3.1%
露光装置関連事業			71	N/A	
合 計	124	33.3%	200	19.9%	△38.0%

■ 基板検査装置関連事業（半導体パッケージ基板検査装置・FPC検査装置）

- ・次世代及び次々世代の半導体パッケージ基板向けのウルトラファインAOIの開発
- ・次世代リペア装置（AOS：光学式自動シェイピング装置）の開発

■ 露光装置関連事業（ロールtoロール型直描露光装置）

- ・2025年3月に事業撤退

AIデータセンター（DC）向け最先端半導体パッケージ基板検査装置の引合いが
高水準で推移、当第4四半期から翌期の2027年4月期に売上計上予定となる
案件を順調に積み上げ

(単位：百万円)

	公表値	前期実績	増減	増減率
売上高	2,300	2,237	63	2.8%
営業利益	120	108	12	10.4%
経常利益	70	116	△46	△40.1%
当期純利益	60	△142	202	－

第1部 2026年4月期 第2四半期決算概況

第2部 今後の成長戦略

Mission

変化を先取りし、革新的な製品を生み出す

今日の社会は人類が経験したことのない速さで変化が進んでいます。
私たちはこの変化を見据え、その先のニーズを先取りした優れた製品を提供します。

社会の繁栄と
発展に貢献

基板検査装置関連事業

- ・進化が加速する微細化・高機能化への対応
- ・生産能力増強及びサプライチェーン強化
- ・台湾、東南アジアへの販促強化

新規事業

- ・M&Aを視野に強力な成長エンジンとなる事業の展開を検討

Value

勇気と挑戦



失敗を恐れぬ挑戦と、
たゆまぬ努力が開く未来への扉

信頼と感謝



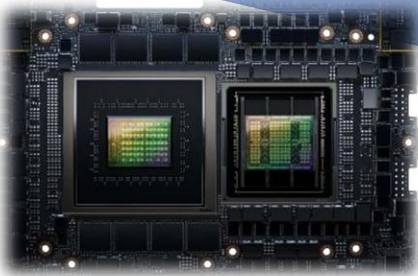
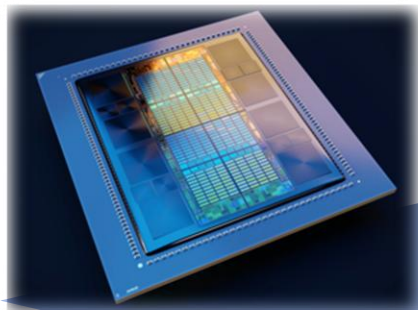
信頼と感謝が築く、
豊かで限りなき共生の輪

学びと成長

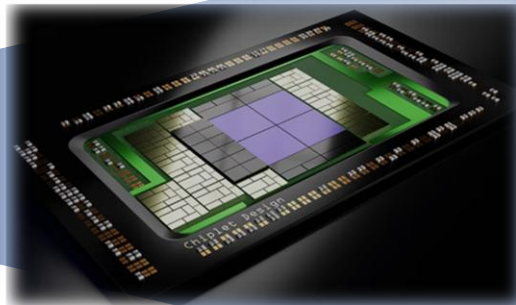


ものづくりは人づくり、
学びと成長はエンドレス

生成AIの急速な普及を背景に、AI対応DC向けの活発な投資が継続 高性能半導体とパッケージ基板の重要性と需要が高まる



NVIDIA GH200 Grace Hopper
(出典元：NVIDIA)



チップレット
(出典元：東京エレクトロン)



データセンター
(出典元：ソフトバンク)

AIサーバーの拡大で、高性能CPU・GPUなどのハイエンドデバイスが急増
微細化、チップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置の開発と販売強化

1. 半導体パッケージ基板の微細化・高度化への対応

- ・L/S=5 μ m/5 μ m→L/S=1 μ m/1 μ m
- ・ガラス基板等への応用
- ・基板パッケージサイズ大型化へ対応

※L/S=ライン/スペース：配線の幅と隣り合う配線同士の間隔



半導体パッケージ基板検査装置

2. FPCの需要拡大への対応

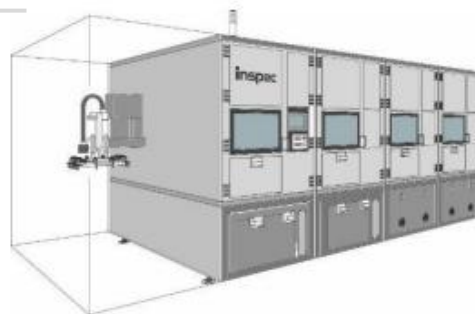
- ・AI搭載スマートデバイス向けFPC需要増
- ・ロール状での超高速検査を実現した主力製品の更なる進化



ロールtoロール型FPC検査装置

3. 全自動化システムの更なる進化

- ・AIサーバー拡大により高性能なCPU及びGPUが急増
- ・拡大する高性能検査装置ニーズへ対応



AI機能付両面全自動検査装置

4. 更なる成長へ向け、事業基盤強化

- ・生産能力増強
- ・サプライチェーン強化
- ・海外拠点の強化
- ・東南アジア地域への販促強化



次世代最先端検査システムの開発を推進

次世代CPU・GPUなどのハイエンドデバイスにおけるチップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置を開発



L/S=5 μ m/5 μ m



L/S=2 μ m/2 μ m



L/S=1 μ m/1 μ m



SX7300



SX7400



SX7500



※SXシリーズ
半導体パッケージ基板向けAOI
(AOI：自動外観検査装置)



生成AIが作り出す未来に SX7000シリーズが貢献

次世代トレンド



ガラス基板
(出典元：東京エレクトロン株式会社)

半導体パッケージ基板は
有機基板からガラス基板へ

検査からリペアまで一貫したソリューションの提供で、お客様の生産効率向上と歩留まり改善に貢献
生成AIやデータセンター市場の拡大とともに高度化する多様な生産現場のニーズに対応

装置名称	次世代半導体パッケージ基板検査装置	レーザーリペア装置
モデル	SX7300／SX7400	LX7000
外観イメージ		
最小L/S	2.0μm/2.0μm / 1.5μm/1.5μm	2μm/2μm
基板サイズ	615mm x 515mm	615mm x 515mm
外形	W:1,590mm×D:2,450mm×H:2,255mm	W:1,935mm×D:2,100mm×H:2,275mm
重量	約2,800kg	約2,500kg

マーケットの動きに応じて販売及びサポート体制を強化



滋賀サポートセンター開設

関西圏及び北陸圏のお客様への迅速かつきめ細かいサービスの提供を目的として、滋賀県草津市に「滋賀サポートセンター」を開設。



滋賀サポートセンター

台湾現地法人の事務所を移転 中国に蘇州サポートセンター開設

台湾の現地法人である台湾英視股份有限公司の事務所を移転、デモ機を設置し、本格的に販促活動をスタート。加えて、お客様のニーズに柔軟に対応するため、中国蘇州にサポートセンターを開設。



台湾英視股份有限公司



蘇州サポートセンター

国内外で展示会に出展



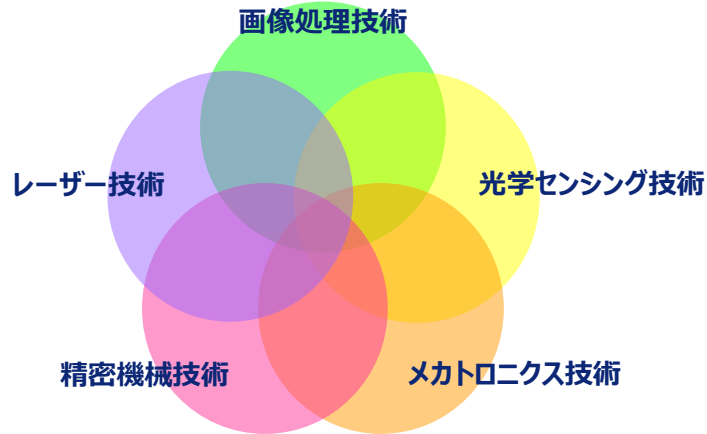
TPCA Show – Taipei-2025 (台湾)
THECA Show 2025 (タイ)
JPCA Show 2025 (日本)

Appendix

確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く

社員が幸せになれる会社、そしてその先の誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会を目指して

確かな技術



切り拓く

インスペックは自社が持つ技術・ノウハウを駆使して、まだ見ぬ明日へチャレンジし続けます。

あくなき挑戦

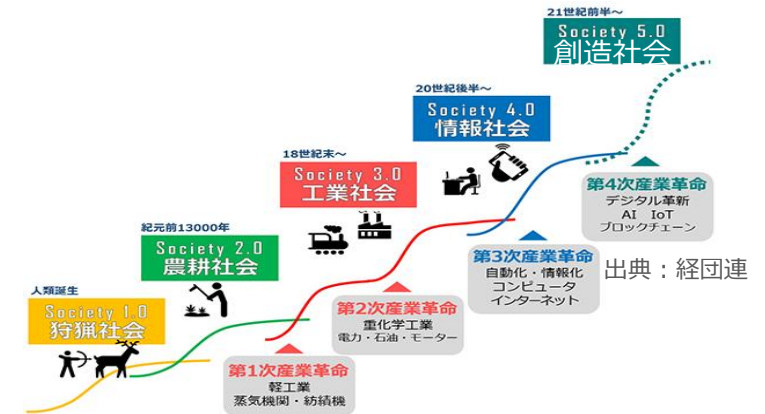


当社の成長を牽引した製品たち



世には出ることにはなかったが、現在の事業の礎となった製品たち

創造社会



創造社会とは、「誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会」とあります。

創造社会の実現に貢献するためには、何よりも第一にインスペックの社員が幸せにならなければなりません。

「社員が幸せになれる会社」への取り組みこそが創造社会の実現への取り組みであり、まさにそのことがインスペックの存在意義です。

20th Century

21st Century

昭和59年
太洋製作所創業



平成3年
新社屋建設

昭和63年
(有)太洋製作所設立

1991

1997

2000

1984

カセットテープ
レコーダー向け
磁気ヘッド
組み立て

1988

ハンディカムの
磁気ヘッド
組み立て

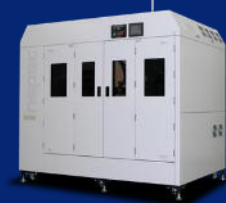


FAシステムの
設計製造受託開始

検査装置第1号
リードフレーム検査装置
MV7000発表



第2世代
リードフレーム検査装置
LF2000発表
ロングセラー製品



平成13年1月1日
インスペック株式会社に社名変更



平成18年
東京証券取引所
マザーズ市場へ上場
本社工場増築

2001

BGA検査装置
BF8000発表
ロングセラー製品



COF検査装置
TR3000発表
シェアトップとなる



2002

2003

2006

ハイエンドPKG基板AOI
SX5000発表
CPU向けPKGに対応

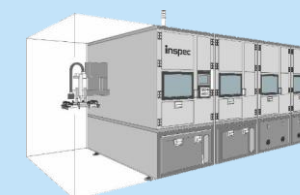


FPC向け
ロールtoロールAOI
RA7000発表



2016

ハイエンドPKG基板AOI
全自動化ライン対応



2/2μm対応検査装置
及びリペア装置発表



SX7000



LX7000

平成29年
東京証券取引所
市場第二部へ市場変更

令和4年
東京証券取引所
スタンダード市場へ変更

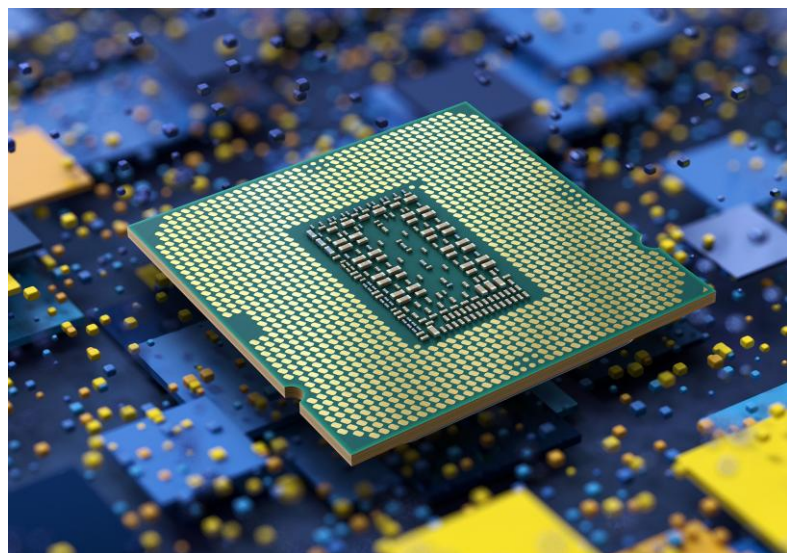
2025

2022

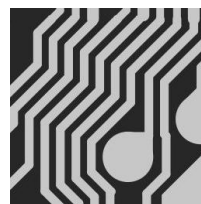
2018

2017

主要製品①：半導体パッケージ基板検査装置



コンピュータのCPU



(パターン検査)

ハイエンドの半導体パッケージ基板向け
AOIは世界で3社のみ

(AOI：自動外観検査装置)

← この部品の**検査装置**を作っています



半導体パッケージ基板検査装置 **SXシリーズ**

主要製品②：ロールtoロール型検査装置



スマートフォン分解図
(出典元：iFixit)

FPC基板等の柔軟な基板をベースにした 電子デバイス検査装置

(FPC：フレキシブル基板)

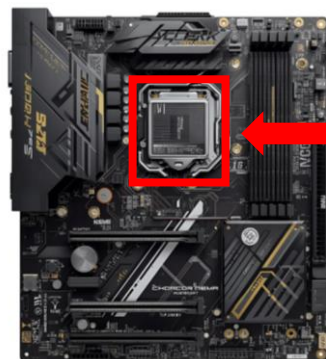
← この部品の**検査装置**を作っています



ものづくり日本大賞
経済産業大臣賞

第9回 ものづくり日本
大賞・経済産業大臣賞

フレキシブル基板検査装置 **RAシリーズ**



マザーボード



半導体パッケージ基板

最先端の半導体パッケージ基板やフレキシブル基板の
品質を担保する役割を担う

スマートフォン分解図
(出典元：iFixit)



精密フレキシブル基板
(出典元：NCネットワーク)

インスペックの製品



半導体パッケージ基板検査装置



ロールtoロール型検査装置

1 高い競争力を持つ最先端の製品を開発し、業界をリードする

2 収益性の高い、競争力のある事業構造を再構築する

3 アジアを中心としたグローバル市場の進出を拡大する

4 人的資本に積極投資し、持続的成長を支える組織力を強化する

5 働きがいが生み出す力で、社会の繁栄と発展に貢献する

不安定な国際情勢による景気下振れリスクが高まるなど、先行き不透明感が継続
半導体市場においては、AI半導体関連を中心に技術の発展、進化のスピードが加速

2026年4月期

マ
ク
ロ
経
済

- ・地政学的リスクの高まり
- ・先進国の少子高齢化による人手不足
- ・新興国の経済成長率拡大
- ・IoT・AIをはじめとするDX推進の加速
- ・サステナビリティに対する世界的な危機感の高まり

半
導
体
・
F
P
C
市
場

- ・シリコンサイクルからスーパーサイクルへ
- ・中国から東南アジアへ半導体市場のシフト
- ・生成AIが牽引する更なる微細化・高密度化
- ・CASE対応への新たな価値創造

事
業
環
境

- ・生成AI向けデータセンターの大規模投資継続による半導体パッケージ基板及びインターポザー向け検査装置の新規需要の高まり
- ・半導体チップの微細化や、チップレット化へ向けた国内外企業の投資が活発化
- ・生成AI搭載スマートフォン需要の増加

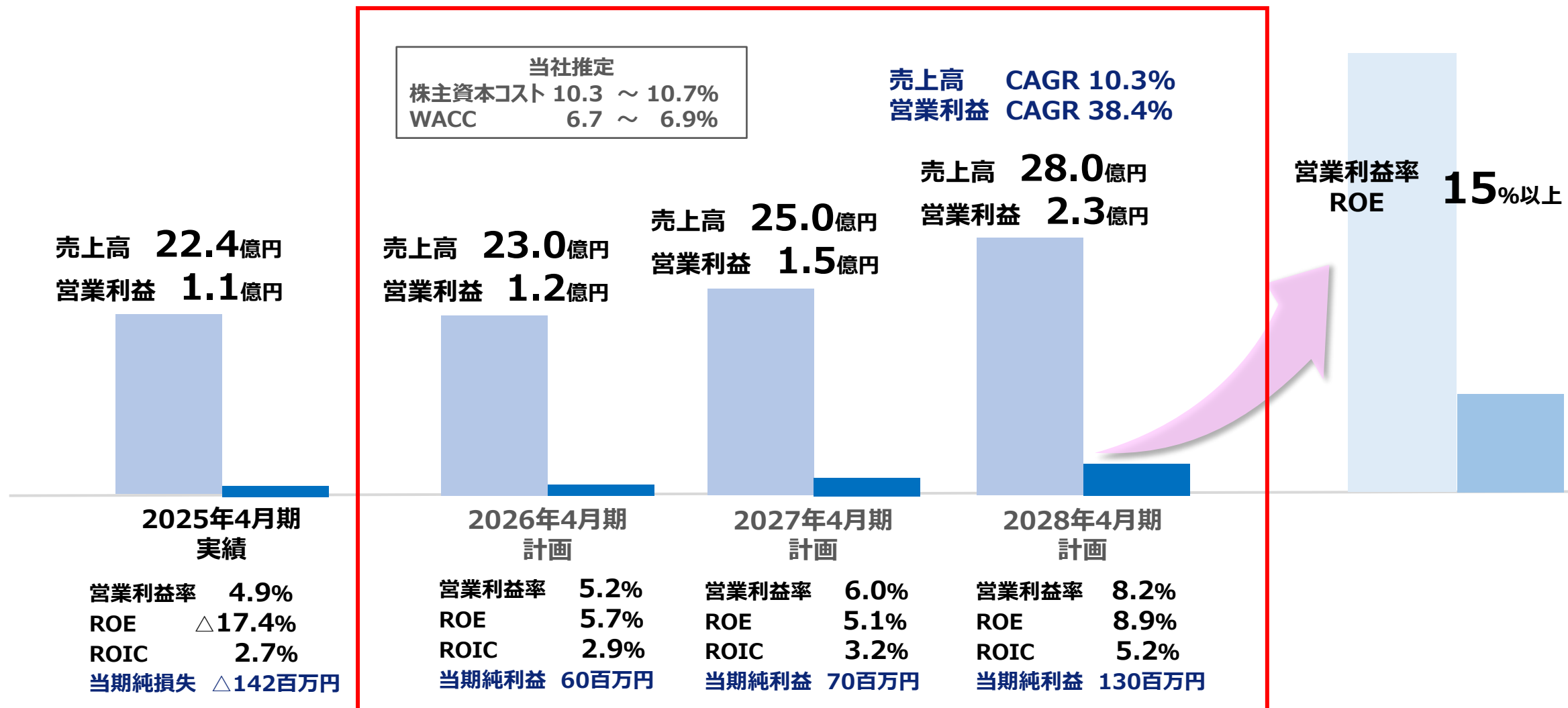
持続的成長と企業価値創造

確かな技術で競争力の高い製品を生み出し、
社会の発展に貢献

生成AIの加速度的進化に伴い、
高性能半導体の市場拡大

半導体・FPC検査の
微細化・高度化対応

持続的成長で営業利益率15%、ROE15%以上を目指す



当社は、パーパス「確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く」を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。

活力ある職場づくり

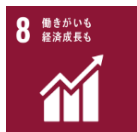
交流・能力開発・仕事と生活の調和によって働きがいのある職場づくり



- 支援学校実習受け入れ
- インターンシップ受け入れ



- 女性社員の雇用・活躍の推進
- 出産・育児・介護休暇の取得推進



- 有給休暇取得推進
- 外部研修の実施



女性マネジメント塾



角館武家屋敷清掃活動

技術開発

検査装置の開発を通じて技術革新に貢献



- 欠陥自動分類技術による人手不足解消への貢献
- 電気自動車等のグリーンエネルギー技術発展への貢献

社会貢献活動

地域社会をはじめとした社会貢献活動を推進



- 開発途上国にワクチン提供支援（ペットボトルキャップ・古着回収）
- 社内献血活動



- 再生可能エネルギー100%（RE100）の電力を導入



- 角館武家屋敷清掃活動
- 地元災害ボランティアへの登録



- フードロス対策自販機の社内設置
- 社内空調にガスエアコンを使用
- 照明のLEDライト化



- あきたSDGsパートナー登録
- 地元スポーツ団体への協賛



私たちは秋田ノーザンハピネッツを応援しています

プロバスケットボールチームオフィシャルスポンサー



半導体パッケージ基板向けAOI『SX5600』

- インスパック基板AOIのフラッグシップモデル
- 最先端の超高精細基板に対応
- クラス最速レベルの生産性を実現



ロールtoロール型FPC検査装置『RA7400』

- ノンストップで高スループットと長尺対応の実現
- ベリファイレスをサポートする自動欠陥分類機能搭載
- コンパクトな外形

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。

本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。